

科技部110年度半導體產學研發聯盟計畫

推廣說明會



計畫徵求公告

半導體產學研發聯盟計畫辦公室

110年1月

簡報大綱

- 一、計畫推動目的與特色
- 二、計畫徵求說明
- 三、計畫審查重點
- 四、申請流程與申請方式
- 五、計畫執行、管考與研發成果重點規範
- 六、常見問題Q&A

REsearch **AL**liance

一、計畫推動目的與特色

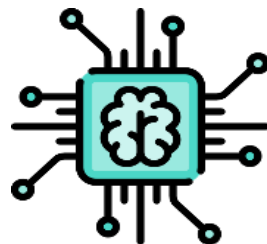
- 106年起科技部為回應半導體產業界提出**前瞻技術研究**及**博士級人才培育**的迫切需求，推動產學研發聯盟合作計畫(REAL)；為持續支持半導體領域產學合作，並鼓勵擴大資源投入與組織規模，自110年度起轉型為**半導體產學研發聯盟計畫**

鼓勵組成
產學研發聯盟



業界現金投入
每年度**不低於**
新台幣**200萬元**

支持產業等級
前瞻技術研究



透過**推薦機構**協助確認
技術研發應為**產業等級**

培育博士級
高階人才



每人每月獎助
至少**4萬元**

二、計畫徵求說明(1/2)

重要時程

- 計畫申請時間：自110年1月11日至2月19日
- 計畫執行期間：自110年4月1日至111年3月31日；得申請多年期計畫(至多三年)

申請資格

- 申請機構：符合本部「補助專題研究計畫作業要點」第二點規定者
- 計畫主持人：符合本部「補助專題研究計畫作業要點」第三點規定者
- 合作企業：符合本部「補助產學合作研究計畫作業要點」第二點規定者

申請組別與檢附文件

- 分為IC設計、製造及封測三組(於申請書註明申請組別)
- 申請書應檢附「計畫推薦審核資料」(附件1)、「申請人與企業之合作約定書」(附件2)
- 推薦機構協助審核，依審核結果出具「推薦計畫證明文件」(附件3)
審核計畫內容為業界認可之產業前瞻技術研究，與吸引業界提供經費投入研發內容之關聯性等

二、計畫徵求說明(2/2)

合作企業 現金出資

現金出資不得少於新臺幣200萬元，須於計畫執行期間內撥付，且應高於向本部申請補助經費

博士生 獎助

參與本計畫之博士生，本部每位每月至少補助2萬元，業界每位每月至少投入2萬元

計畫經費 編列

- 1.業務費：
 - (1)研究人力費：
 - A.專、兼任助理費用及臨時工資
 - B.博士後研究人員費用
 - (2)耗材、物品、圖書及雜項費用：與本聯盟產學合作計畫直接有關之其他費用等
- 2.研究設備費
- 3.管理費
- 4.國外差旅費：出席國際會議差旅費、國外或大陸地區差旅費

三、計畫審查重點

鼓勵 產學合作

- 計畫團隊研究群之執行能力、過去執行產學合作計畫之績效、**預期研發成果及產業外溢效果**等
- 合作企業之資格、研發能力或潛力、出資、承接計畫成果之後續規劃及協助我國相關產業發展之效益
- **吸引業界投入經費**之相關證明文件

產業等級 前瞻技術

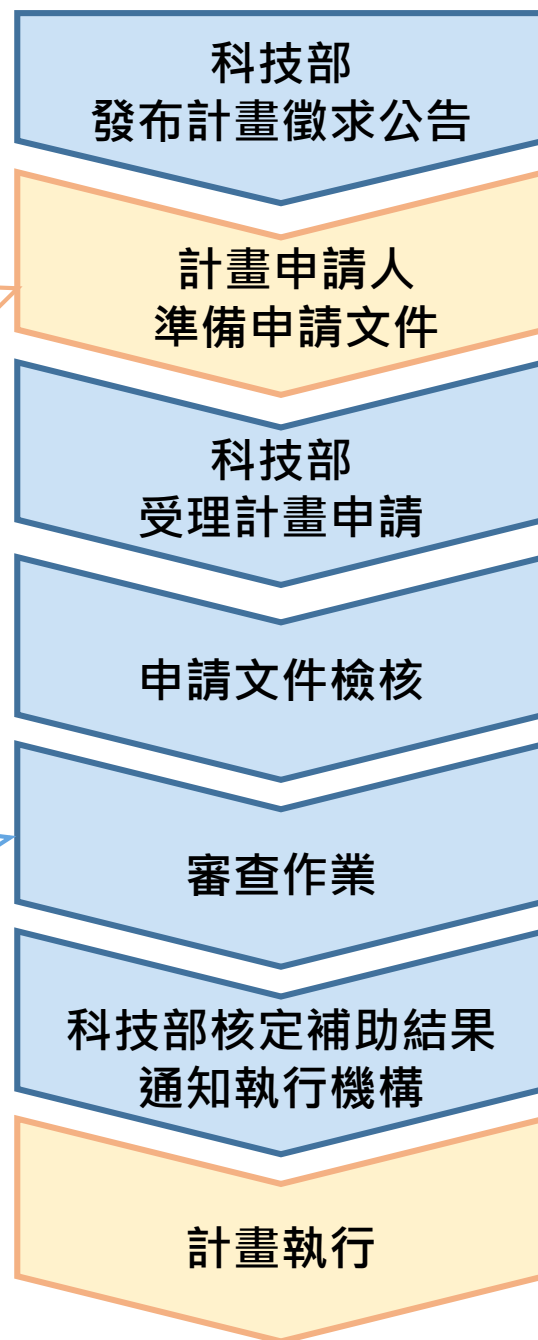
- 以具國際競爭性之**產業前瞻技術**研究為主
- 研究項目及經費需求合理性
- 說明計畫**期中及全程**之預期績效及其達成情形

高階人才 培育

- **優先補助有博士生或博士後參與**、業界承諾額外資助博士生獎助金或吸納博士生誘因等相關承諾之計畫
- 申請人應於計畫申請及執行階段各相關文件，**揭露博士生參與計畫情況**

四、申請流程

- ✓ 申請書
- ✓ 計畫推薦審核資料/推薦計畫證明文件
- ✓ 申請人與企業之合作約定書



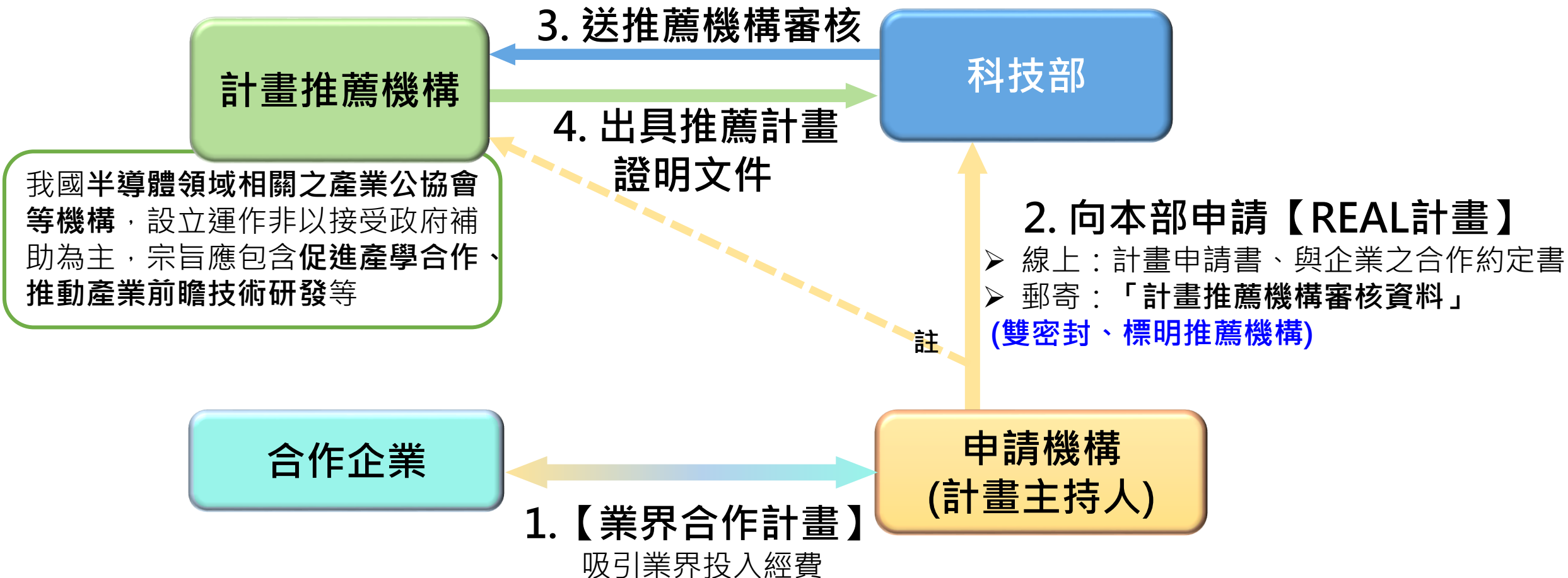
- ✓ 線上書審
- ✓ 簡報複審：書審通過後，計畫團隊至本部進行簡報與詢答

- ✓ 申請書
- ✓ 推薦計畫證明文件
- ✓ 申請人與企業之合作約定書

- ✓ 本部依審查結果核給補助額度，計畫未獲通過補助者，不得提出申覆

四、申請方式(1/4)

為確認計畫前瞻性，依申請人建議之推薦機構，本部將「計畫推薦機構審核資料」送推薦機構進行審核



註：申請人將「計畫推薦機構審核資料」逕送推薦機構審核，取得推薦計畫證明文件後，再另向科技部提出申請書

四、申請方式—申請附件說明(2/4)

附件1

【計畫推薦機構審核資料】

壹、計畫推薦機構之建議(必填)

填寫說明：請填寫計畫推薦機構(限填一機構)之中文完整名稱

貳、業界合作計畫基本資料

填寫說明：若超過一家共同執行公司，請於「共同執行公司一」欄位後列列；若與共同執行公司，相關欄位請留空白或刪除；若有多個學術機構參與，或為多個子計畫之整合型計畫，比照共同執行公司分別列明；計畫總經費請分年列出，若期程超過二年，請自行增列；若為一年期計畫，第二年欄位請留空白或刪除。

計畫名稱	中文			
	英文			
主導公司名稱	(公司全名)			
主導公司計畫主持人		職務		
共同執行公司一名稱	(公司全名)			
共同執行公司一計畫主持人		職務		
主導學術機構/系所(單位)				
主導學術機構主持人		職務		
共同學術機構一/系所(單位)				
共同學術機構一主持人		職務		
是否規劃博士班研究生(或博士級研究人員)共同參與計畫執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
計畫總經費	新臺幣		元(5)	
分年列出	項目	金額(元)	佔年度經費百分比	

附件2

【申請人與合作企業之合作約定書】

本企業(名稱：_____)願參與半導體產學研發聯盟計畫(名稱：_____)，(總)計畫主持人：_____，並遵守下列事項：

一、本企業與(總)計畫主持人等合作，全程參與本研究計畫，並保證提供申請機構研發經費全程總計新臺幣_____仟元。

二、廠商分年撥付研發經費(單位：仟元)

第一年： 第二年： 第三年：

三、合作期間：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

四、本企業所撥付經費，並非來自政府補助款項。

此致

科技部

合作企業負責人：_____ (簽章)

合作企業印 鑑：_____
(備註：至少應由合作企業授權之研發部門主管簽章，毋須加蓋企業之公司大、小章。)

附件3

【○○○○推薦計畫證明文件】(參考格式)

申請人_____ 吸引業界_____ 投入屬產前研發技術研究與開發(合作主題：_____)之研發經費，滿足下列條件：

1. 投入經費執行期間：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止
2. 企業承諾出資研發總經費：_____仟元
(第一年：_____仟元；第二年：_____仟元；第三年：_____仟元)

檢附【申請人與企業之合作合約】

檢附【申請人與企業之合作約定書】以該為據

本機構推薦此計畫申請科技部半導體產學研發聯盟計畫。

此致

科技部

計畫推薦機構負責人：_____ (簽章)

計畫推薦機構印 鑑：_____ (機構章)

中華民國 年 月 日

- 計畫推薦機構之建議必填，限填一機構之中文完整名稱
- 附件：申請人應檢附「申請人與企業之合作約定書」或申請人與企業之合作合約做為佐證材料

- 至少應由合作企業之研發部門主管(含)以上簽章(毋須公司大小章)
- 若有一家以上合作企業，各合作企業應分別填列

- 推薦機構得依本計畫之格式規範(如附件1)，包含但不限於本部格式，設計受理推薦計畫之構想書表
- 推薦機構依審核結果出具推薦計畫證明文件

四、申請方式—合作企業現金出資(3/4)

- 企業現金投入研發**每年度不低於200萬元**
- 企業現金投入**須於本計畫執行期間內撥付**(110年4月1日至111年3月31日)方得認列

● 單年期計畫企業現金投入認列示例

➤ 假設申請人與業界合作計畫執行期間(110/1/1-111/7/31)，業界共投入300萬元

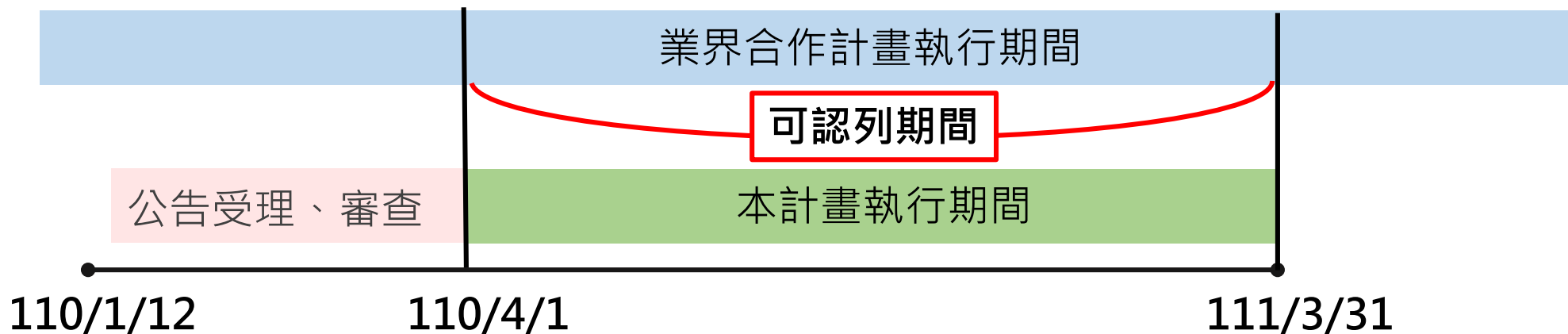
第一期款：於110年1月1日給付50萬元

第二期款：於110年4月30日給付100萬元

第三期款：於111年2月25日給付100萬元

尾款：於111年7月31日給付50萬元

可計算期間，得認列200萬元



四、申請方式—博士生獎助規定(4/4)

- 參與本計畫博士生每位每月補助至少4萬元 (本部+業界)
- 另可同時參與本部「鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案」，本部加碼補助與業界同額獎學金(本部補助 2萬元/月 為上限)

REAL計畫

\$ 本部與業界共同提供博士級人才獎助金

業界獎助
至少2萬/月

+

科技部獎助
至少2萬/月

≥ 4萬元/月

博士生方案

\$ \$ 參與本部博士生方案，可於計畫申請時備齊相關文件一併提出

業界額外補助
1萬元/月以上

+

科技部同額獎助
1萬元/月

≥ 2萬元/月

五、計畫執行、管考與研發成果重點規範

計畫執行

- 執行機構應於計畫執行期間結束三個月前向本部完成請領第二期補助經費款項檢附提供參與計畫**博士研究生獎學金之相關證明文件**及**業界全額出資證明文件**（如匯款或即期支票影本）

計畫管考

- 計畫將依審查結果核定之查核點，進行期中考核計畫執行成效，並得於執行期間增訂查核點，作為計畫考核之依據
- 執行成效未達計畫查核點或本計畫相關規定者，得要求計畫申請機構限期改善，必要時得終止計畫或要求繳回部分經費，並納入本部後續補助之參考
- 報告繳交
 - 二年期以上計畫，應於當年度計畫結束三個月前，線上繳交當年計畫執行之精簡及完整進度報告以供審核，做為下年度之執行依據
 - 結案報告應於計畫結束後三個月內，於線上繳交精簡與完整結案報告

研發成果

- 屬於本部補助之部分，除經本部認定歸屬本部所有者外，全部歸屬計畫執行機構所有；屬合作企業出資部分，由計畫執行機構與合作企業依相關法令規定商議約定之

六、常見問題

【申請】

半導體產學研發聯盟計畫是否有經費補助上限？

本計畫僅規定業界現金出資不得少於新臺幣 200萬元，且應高於向本部申請之補助經費

【申請】

沒有博士生是否能申請半導體產學研發聯盟計畫？

本計畫重點審查項目包含高階人才培育規劃，計畫中有博士生之人才培育規劃，將做為優先補助之審查參考

【申請】

共同主持人之合作企業出資可否列為業界投入經費？

可以。共同主持人之合作企業出資可認列業界投入經費，惟其業界合作計畫與企業出資不可再申請本部或其他政府相關補助

【執行】

半導體產學研發聯盟計畫核定後，如後續廠商有追加預算，是否能辦理補助款增額？

本計畫核定後不能追加補助經費額度

【執行】

進行第二期補助經費請款時，若業界出資仍未達核定清單金額，需如何處理？

主持人執行計畫時，如有任何情況，請先與計畫辦公室聯絡。若於請款時業界出資未達核定清單金額，補助款將依比例減少，另本部得視情節輕重終止補助、追繳補助經費

Q&A時間

REsearch **AL**liance

感謝您的蒞臨

聯絡窗口

科技部產學及園區業務司

● 林技寬先生

電話：(02)2737-7280

E-mail：jklin@most.gov.tw

科技部半導體產學研發計畫辦公室

● 陳于純小姐

電話：(02)2737-7288

E-mail：yuchchen@narlabs.org.tw

● 彭琦靖小姐

電話：(02)2737-7693

E-mail：ccpeng@narlabs.org.tw

● 任昱甄小姐

電話：(02)2737-7829

E-mail：yjren@narlabs.org.tw

附件：相關資訊連結



REAL主辦-說明會報名表
1/18(一)台大場
1/20(三)成大場



TIARA主辦-說明會報名表
1/19(二)中央場
1/21(四)清大場



doc版



odt版

REAL申請書附件下載



TIARA推薦作業說明